

## 36-35 スピンドフリー塗布方法におけるレジスト膜厚プロファイルの最適化

大学院自然科学研究科	教授	久保田 弘
電気システム工学科	助教授	中田 明良
大学院自然科学研究科	後期課程	森川 晃次
電気システム工学科		坂本 賢太郎

半導体製造工程におけるリソグラフィー工程では、近年スループット向上、コスト削減のため基板の大型化が進み、それに伴い装置も大型化し、現在用いられているスピンド塗布法ではレジストの塗布が困難になってきている。そこで現在、スピンド塗布法に変わる新しい塗布方法としてスキャン塗布法が提案され、技術の開発が行なわれている。しかし、スキャン塗布法で形成された膜には膜のエッジ付近に大きな突起が出来るなど様々な問題点がある。本稿ではスキャン塗布法で均一な膜形成を行う為にエッジが出来る原因解明を行なったので報告する。

(第2回 東北大学・熊本大学 大学間連携技術交流会 2002.3.21)